

导热灌封胶

● 产品描述:

Tsealant-2 系列 是一种双组分低粘度的阻燃型封装材料，可室温或者加热固化。其固化后为高分子弹性体，具有防尘、防水、防震、阻燃、密封、粘接、导热等功能。主要应用于电子、电器元器件及电器组件的密封保护，也可用于温度传感器灌封等场合。



● 产品特点:

- 1) 操作时间可调
- 2) 良好的流动性、浸润性
- 3) 优异的绝缘性及耐温性
- 4) 阻燃性能优异

● 应用领域:

- ✓ 汽车电子
- ✓ LED电源
- ✓ 变压器
- ✓ 电子电容

● 使用方法:

- ❖ 可导热灌封胶为A/B桶装，使用前将A、B组各自搅拌均匀，然后按比例称重，混合均匀，将混合好的灌封胶静置消泡，采用真空脱泡效果更佳。在操作时间内将脱泡后的胶料浇注于待灌封件中，静置室温固化或高温加速固化。

导热灌封胶

● 典型性能参数:

参数	单位	Tsealant-2121		Tsealant-2201		Tsealant-2050U		Tsealant-2080U	
类型	---	有机硅		有机硅		聚氨酯		聚氨酯	
密度	g/cm ³	2.4		2.7		1.5		1.8	
颜色	---	A: 深灰	B: 白色	A: 深灰	B: 白色	A: 黑色	B: 棕色	A: 黑色	B: 棕色
硬度	Shore A/D	45/---		25/---		---/45		---/65	
体积电阻	Ω·cm	10 ¹³		10 ¹³		10 ¹³		10 ¹³	
混合粘度	mPa·S	7000		5500		3500		5000	
混合比例	---	100: 100		100: 100		100: 20		100: 15	
导热系数	W/m·k	1.2		2.0		0.5		0.8	
击穿电压	KV/mm ac	6		6		20		15	
操作时间	min@25°C	60		60		35		30	
固化时间	H@25°C	12		12		24		24	
阻燃等级	---	V0		V0		V0		V0	
保质期	Month	6							

● 包装方式:

5Kg、20Kg/桶

● 存储条件:

室温避光密封保存, 湿度 < 75%